



Bd.Chimiei nr. 8
700291
Iași • România

Tel./Fax: +40 232 244.942
office@ems-electra.ro
www.ems-electra.ro



CONDIȚII GENERALE DE FABRICARE A PLĂCILOR ELECTRONICE

1. CONDIȚII TEHNICE. PERFORMANȚE.

- Dimensiunea maximă a plăcii sau panoului (plantare SMD și THT) 380 x 380 mm
- Grosimea circuitului imprimat 0,8 – 4 mm
- Cea mai mică componentă SMD 0402(1mm x 0,5 mm)
- Dimensiuni maxime componente SMD 42 x 42 x 12mm
- Distanța dintre terminalele circuitelor integrate SMD (pitch) min. 0,4 mm
- Tipuri de capsule circuite integrate SMD SOP, QFP, QFN, SSOP, BGA
- Numărul maxim de plăci pe panou 99 bucăți

*Observație:

Pentru realizarea unor plăci electronice ale căror caracteristici nu se încadrează în condițiile tehnice generale de mai sus sau se apropie de limitele precizate, vă rugăm să ne contactați în vederea analizării posibilității de fabricare.

2. COMENZILE vor fi însoțite de următoarele documentații, în limba română sau engleză:

- Lista de componente corespunzătoare plăcii, conținând cel puțin: denumirea, valoarea, simbolul și numărul de bucăți. La sfârșit se vor adăuga observațiile referitoare la aspectele specifice pentru plantarea plăcii respective (zone care trebuie protejate, poziție etichete, etc.) și se vor specifica materialele auxiliare necesare pentru asamblarea finală și eventual alte materiale auxiliare care intră în componența produsului respectiv;
- Dispunerea de componente (față-verso) corespunzătoare plăcii;
- Aspectul circuitului imprimat (față-verso) și numărul de circuite de pe panou;
- Fișier specific pentru plantarea componentelor SMD (pick&place) cu coordonatele în mm, sau fișier cu extensia “*.max”, realizat cu programul ORCAD Layout;
- Alte specificații referitoare la procesarea plăcilor:
 - dacă placa urmează să fie asamblată cu o alta sau va fi montată pe un suport
 - standarde aplicabile, criterii de acceptare, etc.)
 - modul de ambalare al plăcilor asamblate.

Preferăm ca documentația să fie în format electronic (fișiere) pentru o ușoară prelucrare.

Atenție! Fișierul pentru plantarea componentelor SMD se recomandă să fie generat astfel încât toate coordonatele componentelor să fie pozitive și să corespundă centrului capsulei acestora.

Fișierul va trebui să conțină cel puțin următoarele informații:

- codul de identificare al componentei (R15, C43, U25,)
- valoarea componentei (BC847, 220pF, 470Ohm, HCF4093, ...)
- coordonata pe axa x (în milimetri)
- coordonata pe axa y (în milimetri)
- unghiul de rotire în grade
- tipul de capsulă (exemplu SOT23, 1206, 0805, SOD80, etc.)

Exemplu:

Ref.	Valoare	x	y	rotire	capsulă
R1,	470,	34.61,	18.64,	180,	1206
U1,	BC847,	48.13,	19.89,	90,	SOT23